

HS2286-AP

英特尔® 至强® 6900系列双路服务器-符合OCSP2.0规范



产品特点 Features

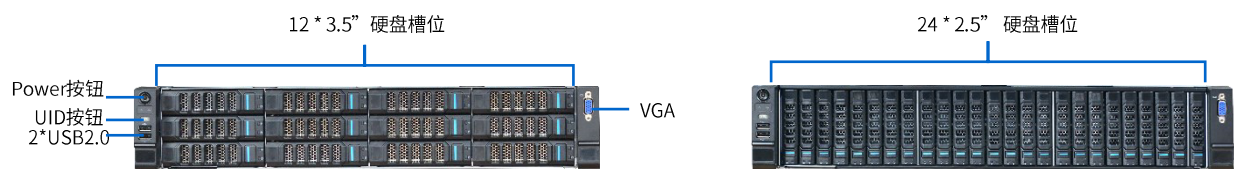
- 支持2颗英特尔® 至强® 6900系列处理器
- 支持24根DDR5内存插槽，速率支持6400MT/s，MRDIMM 8800MT/s
- 支持多种不同的储存配置
- 支持最大10个PCIe扩展插槽，支持PCIe5.0×16
- 2个OCP3.0标准插槽，可灵活配置OCP3.0网卡
- DC-SCM2.0模块，AST2600，支持IPMI2.0
- 符合OCSP2.0规范，模块化设计，主板和外设解耦
- 支持CPU液冷方案



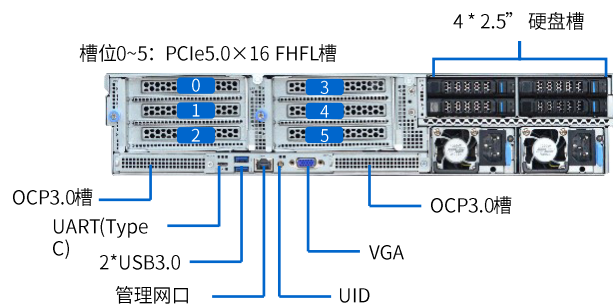
规格参数 Specifications

产品名称/型号	Intel BHS-AP 2U双路服务器HS2286-AP
处理器	支持双路英特尔® 至强® 6900旗舰级处理器（SRF/GNR-AP） 单处理器最大支持288Cores/550W TDP
内存	支持24个DDR5内存槽位，速率最高支持6400MT/s，最多支持24条MRDIMM 8800MT/s内存（GNR）
存储	支持多种不同的硬盘配置，硬盘支持热插拔 前置：支持多达12个3.5英寸SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD)或者24个2.5英寸SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD) 后置：支持多达4个2.5英寸SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD) 内置：支持2个NVMe M.2 2280
Raid支持	可选配高性能RAID控制器，支持SAS4.0/SATA3.0，支持RAID0/1/10/5/50/6/60等，支持Cache超级电容保护
PCIe扩展	风冷配置最大支持10个单宽PCIe5.0×16扩展槽位，2个热插拔OCP3.0槽位
GPU支持	支持2张双宽GPU加速卡，支持P2P
网络	板载1个管理网口 板载2个OCP3.0网卡槽位，可选配标准OCP3.0网卡
IO接口	前置：2个USB2.0，1个VGA 后置：2个USB3.0，1个VGA，1个管理网口，1个串行端口（USB TypeC形态） 内置：TPM安全模块接口
风扇	6个热插拔风扇，支持N+1冗余
电源	2个热插拔1300W/1600W/2000W/2600W/2700W/3200W CRPS标准电源，支持1+1冗余
BMC	DC-SCM2.0管理模块，集成BMC AST2600芯片，支持IPMI2.0/Redfish
尺寸	87mm(高)×447.4mm(宽)×799mm(深)
工作温度	10°C~35°C

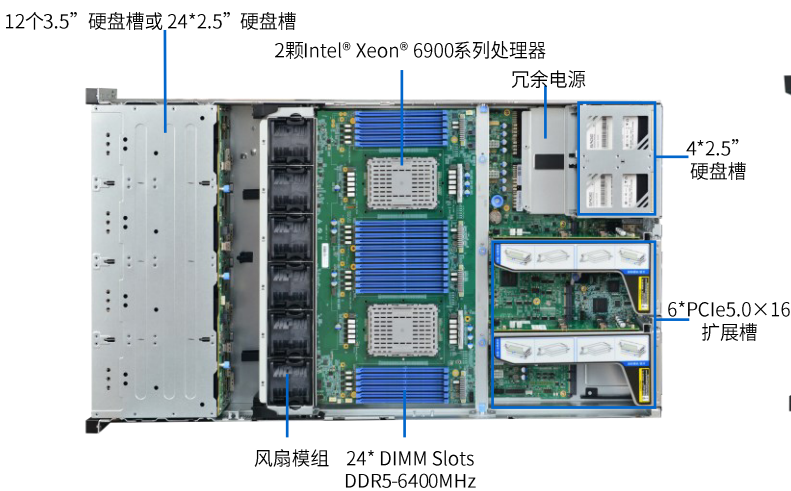
前视图



后视图



内部构造图



液冷散热



订购信息

Ordering Information

SKU	CPU	DDR5	Storage	PSU
HS2286-AP-3TX12RC	Dual Socket BR (LGA-7529) Intel® Xeon® 6900系列处理器	24*DDR5内存槽	12* 3.5" 硬盘槽	2*1600W电源
HS2286-AP-2TN25RC	Dual Socket BR (LGA-7529) Intel® Xeon® 6900系列处理器	24*DDR5内存槽	24* 2.5" 硬盘槽	2*1600W电源